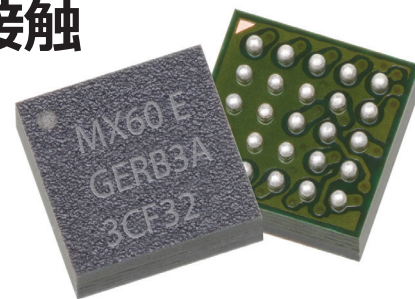


MX60 ギガビットイーサネット向け非接触コネクティビティソリューション



MX60 ギガビットイーサネット向け非接触コネクティビティソリューション

ギガビットイーサネット向けの非接触コネクティビティソリューション、MX60は、高速無線接続用の接続製品として、従来型の機械式コネクタに置き換わるワイヤレストランシーバーです。アンテナが内蔵されており、設計が容易で高振動アプリケーションや過酷環境に耐える堅牢性を備えています。

特徴・利点

BluetoothやWi-Fi、ワイヤレス充電機器等からの電波干渉を受けない特性を維持し、非接触での接続機能を追加した堅牢コネクタ

60 GHz帯無線通信

製品への無線テクノロジー実装の設計が容易に

アンテナが内蔵されており、設計や組み立てが容易

1ペアあたり1~5.4 Gbpsの通信容量が実現し、ほかの無線技術では対応できなかったアプリケーションへの利用が可能

高速伝送速度

ワットより小さい、ミリワットの消費電力

低消費電力

ピッチ	0.50mm
長さ	3.00mm
幅	3.00mm
高さ	0.90mm
使用温度範囲	標準: 0 ~ +70°C 拡張版: -30 ~ +85°C

市場・アプリケーション

ワイヤレスインフラストラクチャ

モニターコンソール
モニターパネル

産業用オートメーション

ファクトリーオートメーションシステム
ロボット

MedTech (メドテック)

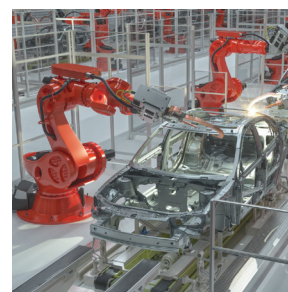
非接触型ネットワークシステム
滅菌の必要な機器

ネットワーク

ドッキングステーション
堅牢ネットワークシステム
防水ネットワークアダプタ



モニターパネル



ファクトリーオートメーションシステム



滅菌装置



堅牢ネットワークシステム

MX60 ギガビットイーサネット向け非接触コネクティビティソリューション

製品特徴・仕様

参考データ

梱包形態: トレー、テープおよびリール
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: 適合

電気的性能

最大定格電圧: 1.2V、1.8V(オプション)

通信速度

専有周波数帯域 (OBW) 7 GHz以下で最大5.4 Gbps
ASK方式
出力: - 0.8dBm (搬送波モード)
平均受信感度 (5.4 Gbps): - 21.3dBm
アンテナ利得: 6.5 dBi
合計放射電力 (EIRP): 5.7 dBi

機械的性能

ピッチ (ボール間): 0.50mm 嵌合高さ: 0.90mm
幅: 3.00mm
長さ: 3.00mm

物理的性能

ピン数25、VFBGA
使用温度範囲:
標準: 0 ~ +70°C
拡張版: -30 ~ +85°C

